

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-006

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

对外投资（设立子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，根据公司战略发展规划，结合中央出台的一系列重大政策，高规格、高定位支持粤港澳大湾区快速发展，公司拟在粤港澳大湾区进行投资。公司拟设立全资子公司深圳惠丰半导体材料有限公司（名称暂定，以工商注册为准。以下简称“惠丰半导体”或“子公司”），注册资金1,000万元，经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（最终以工商注册为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟全资设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳惠丰半导体材料有限公司（名称暂定）

注册地址：深圳市坪山区兰竹东路八号同力兴工业园（以工商注册为准）

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（以工商注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
柘城惠丰钻石科技股份有限公司	1,000 万元	现金（人民币）	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是基于新材料尤其是加工半导体材料等业务未来发展战略及长远规划所需，有利于公司进一步完善产业布局，占领技术高地，为公司培育新的利润增长点，实现公司长远稳步发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司的内部控制管理制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，从长期发展看，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日